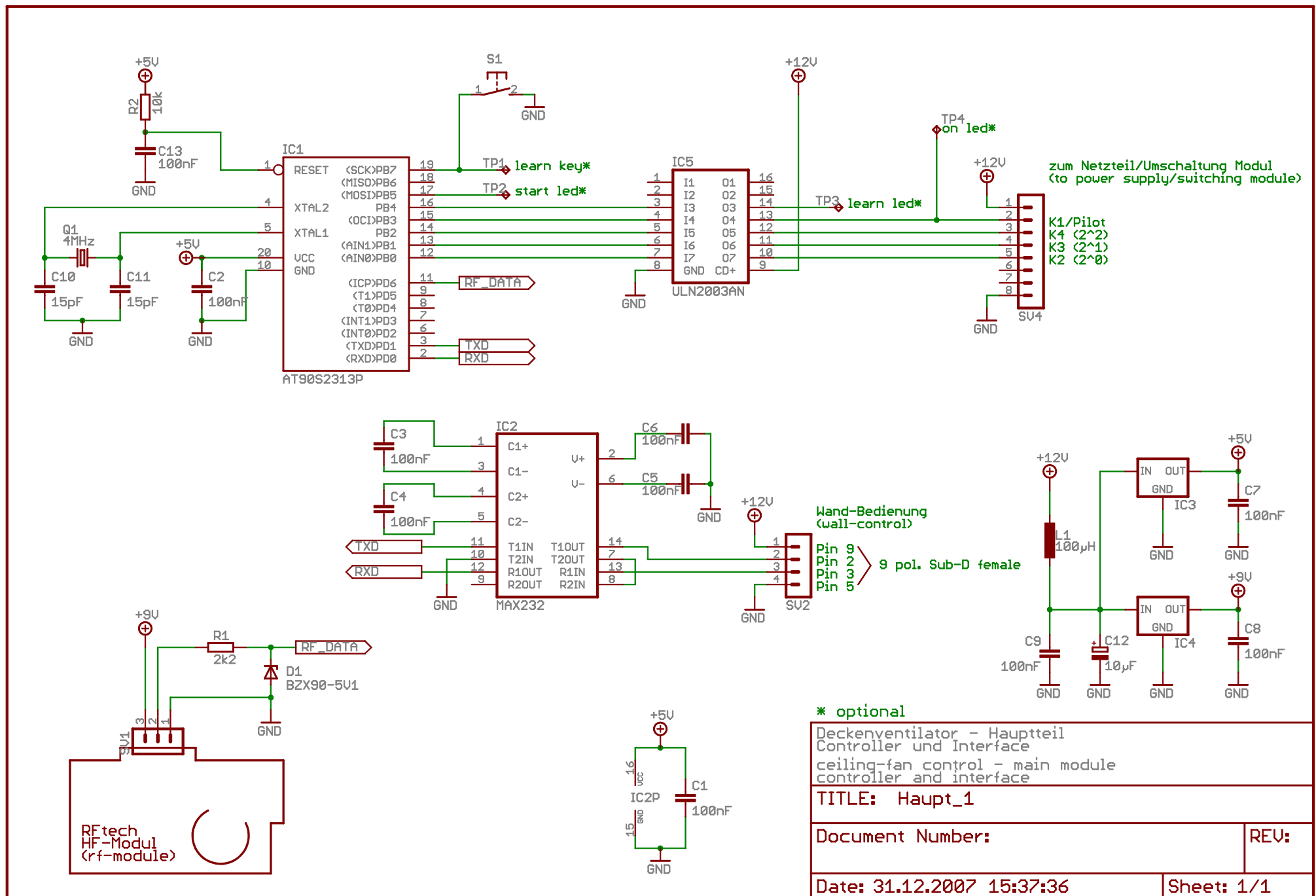
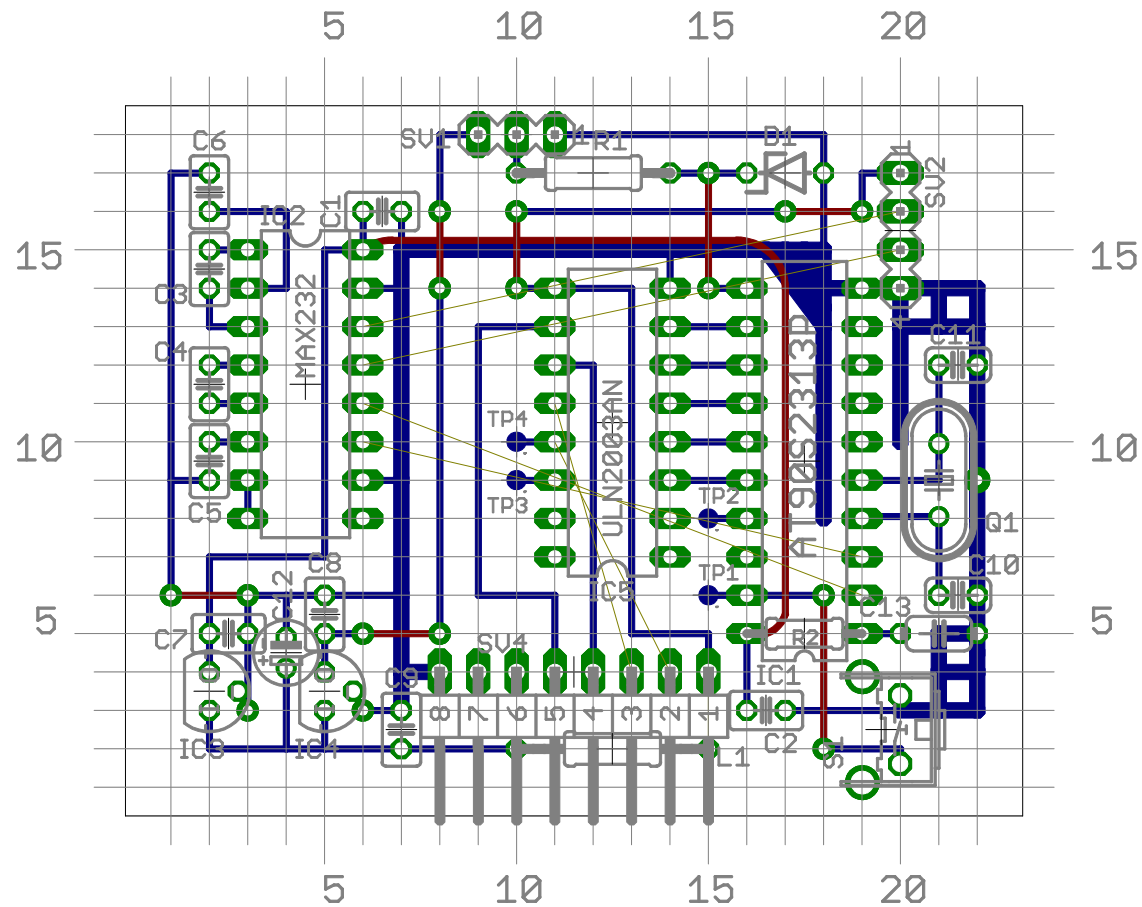






Hauptmodul MC und Interface

L1 und R2 auf Unterseite

Verbindung IC1-20 ->IC2-16
mit isolierter Litze
verlegt wie eingezeichnet

Luftleitungen (gelb) mit 0,2mm
Fädeldraht verlegt

Gehäuse von Q1 an GND gelötet

main module mc and interface

L1 and R2 on bottom side

connection IC1-20 ->IC2-16
with insulated wire
laid as drawn

airwires (yellow) laid with
0,2mm thread-wire

housing of Q1 soldered to GND